

第3【設備の状況】

1【設備投資等の概要】

当社グループ（当社及び連結子会社）では、当連結会計年度において1,264億円（前連結会計年度比24.6%減）の設備投資を行いました。

テクノロジーソリューションでは、アウトソーシングビジネスの拡大を図るため、館林システムセンター新棟の開設をはじめとして国内データセンターの拡充を図ったほか、海外においても、英国を中心にデータセンターなどのアウトソーシング設備の拡充を行い、747億円を投資いたしました。

ユビキタスプロダクトソリューションでは、パソコン、携帯電話の新機種対応に向けた設備投資などで、86億円を投資いたしました。

デバイスソリューションでは、LSI製造設備の基盤ライン再編に伴う投資のほか、電子部品関連の製造設備などで、300億円を投資いたしました。

なお、設備投資額につきましては、上記セグメント以外に129億円が含まれております。

ユビキタスプロダクトソリューションのHDD事業における海外製造拠点であったFujitsu Computer Products Corporation of the Philippines カーマルレイ工場（フィリピン）及びFujitsu (Thailand) Co., Ltd. 本社工場（タイ）は、HDD事業の譲渡完了に伴い、当社の主要な設備ではなくなりました。前連結会計年度末における両設備の内容は以下のとおりです。

会社名及び事業所名 (所在地)		設備の内容	投下資本（百万円）				
			建物 及び 構築物	機械 及び 装置	工具、 器具及び 備品	土地 (面積千㎡)	合計
在外子 会社	Fujitsu Computer Products Corporation of the Philippines カーメルレイ工場 (フィリピン)	HDD製造 設備	1,526	2,347	136	- (283)	4,009
	Fujitsu (Thailand) Co., Ltd. 本社工場 (タイ)	HDD製造 設備	3,570	5,315	984	523 (114)	10,392

2【主要な設備の状況】

当社グループ（当社及び連結子会社）における主要な設備は、以下のとおりです。

(1) テクノロジーソリューション

平成22年3月31日現在

会社名及び事業所名 (所在地)	設備の内容	投下資本（百万円）					従業員数 (人)	
		建物 及び 構築物	機械 及び 装置	工具、 器具及び 備品	土地 (面積千㎡)	合計		
提出 会社	富士通ソリューション スクエア (東京都大田区)	システム開発 設備	14,809	64	1,211	11,971 (24)	28,058	4,095
	幕張システムラボラトリ (千葉市美浜区)	システム開発 設備	8,890	7	430	3,708 (14)	13,035	737
	館林システムセンター (群馬県館林市)	アウトソーシ ング設備	17,454	128	6,117	1,913 (126)	25,614	147
	小山工場 (栃木県小山市)	光伝送システ ム製造設備	3,707	146	778	299 (167)	4,931	227
	那須工場 (栃木県大田原市)	移動通信シス テム製造設備	2,284	259	1,553	1,250 (184)	5,347	513
国内子 会社	富士通エフ・アイ・ピー株式 会社 横浜センタ (横浜市都筑区) (注) 3.	アウトソーシ ング設備	4,790	-	4,977	- (-)	9,768	274
	富士通エフ・アイ・ピー株式 会社 東京センタ (川崎市中原区) (注) 3.	アウトソーシ ング設備	1,631	-	3,311	- (-)	4,942	329
	富士通フロンテック株式会社 新潟工場 (新潟県燕市)	金融・自動機 関連機器製造 設備	1,720	229	1,384	1,611 (47)	4,946	551
	株式会社富士通ITプロダク ツ 本社工場 (石川県かほく市)	コンピュータ 製造設備	1,753	555	585	388 (129)	3,283	789
在外子 会社	Fujitsu Services Holdings PLC (イギリス他) (注) 4.	システム開発 設備及びアウ トソーシング 設備	14,167	1,114	20,316	- (-)	35,597	17,001
	Fujitsu Technology Solutions (Holding) B.V. アウグスブルク工場 (ドイツ) (注) 5.	サーバ及びパ ソコン製造設 備	5,052	1,677	956	2,373 (182)	10,060	1,658
	Fujitsu Network Communications, Inc. リチャードソン工場 (米国テキサス州)	光伝送システ ム製造設備	3,148	739	2,562	2,173 (598)	8,622	1,272

(2) ユビキタスプロダクトソリューション

平成22年3月31日現在

会社名及び事業所名 (所在地)	設備の内容	投下資本(百万円)					従業員数 (人)
		建物 及び 構築物	機械 及び 装置	工具、 器具及び 備品	土地 (面積千㎡)	合計	
株式会社島根富士通 本社工場 (島根県簸川郡斐川町) (注) 6.	パソコン製造 設備	1,684	955	73	- (110)	2,713	645
富士通アイソテック株式会社 本社工場 (福島県伊達市)	パソコン製造 設備	1,175	210	134	591 (73)	2,112	775
富士通モバイルフォンプロダ クツ株式会社 本社工場 (栃木県大田原市) (注) 7.	携帯電話製造 設備	96	1,237	137	- (-)	1,471	215

(3) デバイスソリューション

平成22年3月31日現在

会社名及び事業所名 (所在地)	設備の内容	投下資本(百万円)					従業員数 (人)
		建物 及び 構築物	機械 及び 装置	工具、 器具及び 備品	土地 (面積千㎡)	合計	
富士通マイクロエレクトロ ニクス株式会社 三重工場 (三重県桑名市) (注) 8. (注) 9.	半導体 製造設備	34,682	22,234	1,470	4,327 (307)	62,714	1,404
富士通マイクロエレクトロ ニクス株式会社 岩手工場 (岩手県胆沢郡金ヶ崎町) (注) 9.	半導体 製造設備	4,654	2,901	709	2,881 (290)	11,147	696
富士通マイクロエレクトロ ニクス株式会社 会津若松工 場(福島県会津若松市) (注) 9.	半導体 製造設備	1,853	826	298	3,146 (259)	6,124	568
富士通セミコンダクターテ クノロジ株式会社 本社工場 (福島県会津若松市) (注) 10.	半導体 製造設備	7,952	703	50	- (62)	8,706	587
新光電気工業株式会社 高丘工場 (長野県中野市)	リードフレー ム等製造設備	4,611	3,568	720	2,109 (94)	11,010	955
新光電気工業株式会社 若穂工場 (長野県長野市)	PLP製造 設備	4,762	5,365	81	349 (17)	10,558	513
新光電気工業株式会社 新井工場 (新潟県妙高市)	リードフレー ム等製造設備	3,402	3,395	234	1,149 (122)	8,182	995
新光電気工業株式会社 更北工場 (長野県長野市)	PLP等製造 設備	3,014	7,007	673	615 (45)	11,311	1,221

(4) その他

平成22年3月31日現在

会社名及び事業所名 (所在地)	設備の内容	投下資本(百万円)					従業員数 (人)
		建物 及び 構築物	機械 及び 装置	工具、 器具及び 備品	土地 (面積千㎡)	合計	
国内子 会社 富士通テン株式会社 神戸工場 (兵庫県神戸市) (注) 11.	車載機器の開 発・製造設備	3,963	835	2,532	1,638 (43)	8,969	2,874

(5) 共通

平成22年3月31日現在

会社名及び事業所名 (所在地)	設備の内容	投下資本(百万円)					従業員数 (人)
		建物 及び 構築物	機械 及び 装置	工具、 器具及び 備品	土地 (面積千㎡)	合計	
提出 会社 川崎工場 (川崎市中原区)	ソフトウェア、情報シ ステム及び通信 システムに関 する研究開発 設備	12,255	122	5,656	3,432 (162)	21,467	8,566
	沼津工場 (静岡県沼津市)	ソフトウェア 開発設備	7,608	937	4,784	3,737 (549)	17,067
国内子 会社 株式会社富士通研究所 厚木研究所 (神奈川県厚木市) (注) 6.	ソフトウェ ア、情報シ ステム、通信シ ステム及び電 子デバイスに 関する研究開 発設備	2,619	1,506	1,178	- (19)	5,304	403

- (注) 1. 投下資本は期末帳簿価額によります。なお、投下資本の合計額には、建設仮勘定は含みません。投下資本の期末帳簿価額にはリース資産の期末帳簿価額を含んでおります。
2. 投下資本の機械及び装置には、車両及び運搬具を含みます。
3. 富士通エフ・アイ・ピー株式会社横浜センタ及び東京センタは、それぞれ建物を賃借しております。また、横浜センタ及び東京センタの投下資本の合計額には、それぞれ1,239百万円、1,988百万円のリース資産を含んでおります。
4. Fujitsu Services Holdings PLCの数値は連結決算数値であり、投下資本の合計額には、4,709百万円のリース資産を含んでおります。また、建物の一部を賃借しております。
5. Fujitsu Technology Solutions (Holding) B.V. アウグスブルク工場の設備の一部は、ユビキタスプロダクトソリューションに該当する設備です。
6. 株式会社島根富士通本社工場及び株式会社富士通研究所厚木研究所の土地はすべて当社から賃借しているものです。
7. 富士通モバイルフォンプロダクツ株式会社本社工場は、当社より当社の建物の一部を賃借しております。
8. 富士通マイクロエレクトロニクス株式会社三重工場の投下資本の合計額には、14,476百万円のリース資産を含んでおります。
9. 富士通マイクロエレクトロニクス株式会社は、平成22年4月1日付で富士通セミコンダクター株式会社に変更しております。
10. 富士通セミコンダクターテクノロジー株式会社の土地はすべて富士通マイクロエレクトロニクス株式会社より賃借しているものです。
11. 富士通テン株式会社神戸工場の投下資本の合計額には、1,129百万円のリース資産を含んでおります。

3 【設備の新設、除却等の計画】

当社グループ（当社及び連結子会社）の当連結会計年度後1年間の設備投資計画（新設・拡充）は1,700億円であり、事業の種類別セグメントごとの内訳は次のとおりであります。なお、重要な施設の新設、拡充、改修の計画はありません。

事業の種類別セグメントの名称	平成22年3月末計画額 (億円)	設備等の主な内容・目的
テクノロジーソリューション	1,000	国内データセンター設備及び英国におけるアウトソーシング設備
ユビキタスプロダクトソリューション	100	パソコン製造設備及び携帯電話製造設備
デバイスソリューション	400	L S I 製造設備及び電子部品製造設備
その他、全社（共通）	200	オーディオ・ナビゲーション機器、移動通信機器及び自動車用電子機器の開発・製造設備
計	1,700	

(注) 1. 所要資金1,700億円は、主として自己資金により充当する予定です。

2. 設備投資の計画額は、消費税抜きで表示しております。

3. 経常的な設備の更新のための除・売却を除き、重要な設備の除・売却の計画はありません。

4. 全社（共通）は、一般管理部門及び基礎的試験研究等のセグメントに配賦不能な設備投資額です。